****

***【プレスリリース】***

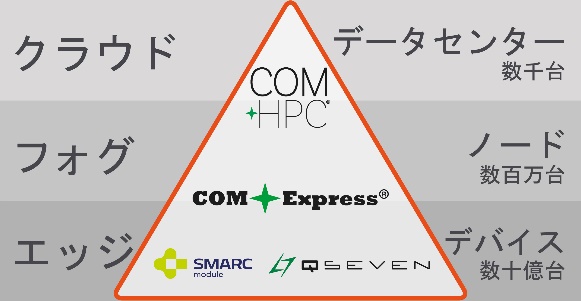
2020年12月22日

報道関係各位

\*本プレスリリースは、[独congatec AGが、2020年11月10日（現地時間）、ドイツで発表したプレスリリース](https://www.congatec.com/jp/congatec/press-releases/article/embedded-at-the-edge-and-in-the-fog/)の抄訳です。

**コンガテック、フォグコンピューティング市場向け  
ソリューションプラットフォームを拡張**

**フォグのエッジにおける組込みを強化**

**

高性能組込みコンピューティング製品のリーディングサプライヤである[congatec（コンガテック）](http://www.congatec.jp/)は、組込みおよびエッジ向け製品を拡張したソリューションプラットフォームをフォグコンピューティング市場に投入しました。様々な産業および基幹業務ネットワークアプリケーションで活用される頑強なフォグコンピュータは、ネットワークコンピューティングの通信プラミッドにおいてエッジデバイス層の上位に位置します。フォグコンピュータは、オンプレミスと基幹ネットワークインフラの展開により実現される信頼性の高いリアルタイムのクラウドサーバとして、エッジコンピューティング市場を支えます。フォグとエッジデバイスを一体化したリアルタイムのエッジコンピューティング市場が形成されてきたことで、過酷な環境に耐える組込みコンピューティングの重要性が急速に高まっています。世界のエッジコンピューティング市場は2019年には35億米ドル規模まで拡大し、2020年から2027年の間に年平均37%（CAGR）を超えるペースで成長すると予測されています[1]。代表的なアプリケーションとしては、予測AIを用いたインダストリー4.0やIIoTコンピューティングから、フォグノードのメッシュを用いたビデオ分析などがあります。そして、異常検出、リアルタイム追跡、データインサイトを可能にし、映像をインテリジェントかつ容易に処理します。こうした技術が特に威力を発揮する代表的な産業分野には、エネルギー・公益事業、製造、ロボット・制御、輸送・物流、スマートシティ、住宅・ビル、ヘルスケア、農業、小売、産業用ウェアラブル、データセンターなどがあります。

エッジ機器や基幹ネットワークアプリケーション向けのフォグでは、標準的なリアルタイム処理、通信および制御に加え、人工知能（AI）や仮想現実（VR）、拡張現実（AR）用ソリューションが実行されることがあります。製薬会社や医療機関では、COVID-19のパンデミックに効果的に対処するため研究開発を可及的速やかに強化して最適化する必要があり、需要が急速に拡大しています。VR/ARは、遠隔支援ができる価値の高いソリューションとして、不要な移動を回避したり、eラーニングを容易にしたりすることから、学校や大学の閉鎖に伴い需要が急増することも考えられます。コンガテックはこうしたニーズにいちはやく対応できるよう、COM Express Type 7のソリューションと最新の標準規格であるCOM-HPCを用いたプラットフォーム製品を提供します。これらは、リアルタイムハイパーバイザ技術による完璧なパフォーマンスバランスを実現し、プロセッサモジュールを変更するだけでフォグ新世代のパフォーマンスを拡張し、総所有コストを大幅に削減できます。

コンガテックの最高経営責任者（CEO）であるジェイソン・カールソン（Jason Carlson）は次のように述べています。「リアルタイムのエッジコンピューティングにおける課題は、フォグサービスとエッジデバイスの両方に最適な設定を見つけ、TSN（time sensitive networking）を通じて双方を接続できるようにすることの難しさです。エッジでは大量のタスク管理を必要とし、OEMメーカーやエンドユーザはそれぞれに異なる組み合わせでコンピューティング能力を必要としています。コンガテックは、モジュールによってこうしたニーズにハードウェアとソフトウェアの両面から応え、単一のソースで様々な用途に最適化された各種アプリケーションに対応するプラットフォームを提供します」

コンピュータ・オン・モジュールにおける世界的なリーダーであるコンガテックは長年、ハードウェアレベルのモジュール方式によって圧倒的な性能と機能を提供してきました。リアルタイム仮想マシン用の独自のハイパーバイザーソフトウェアは、ソフトウェアレベルでフォグサーバ プラットフォームをまとめ上げ、これを利用する開発者が、顧客に最適で頑強なフォグをすばやく構築する基盤を構築します。コンガテックは今後、製品やサービスをさらに拡張し、ビジョンやAI、VR、AR、ビッグデータ分析をはじめとするソリューションパートナーとの連携を進めていきます。こうした連携にはさらに、フォグサーバの仮想マシン構成に搭載するエッジコンピューティング専用のサービスも含まれ、IoTゲートウェイや脆弱性や攻撃、異常検知のためのIoTゲートウェイやセキュリティ機能、あるいは高度なセキュリティを要するアプリケーションに用いられるFIPS 140-2レベル3やBSIコモンクライテリアEAL5規格などの高度な認定暗号機能を提供します。

[1] <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-computing-market>

**##**

**コンガテックについて**コンガテックは、産業用組込みコンピューティングに特化したテクノロジーと製品で急速な成長を遂げている企業です。高性能コンピュータモジュールは、産業オートメーション、医療、輸送、通信、その他多くの業種のさまざまな用途やデバイスに対応しています。スタートアップからグローバル優良企業まで、優れた顧客基盤をもつコンピュータ・オン・モジュール分野のグローバルマーケットリーダです。2004年設立、ドイツのデッゲンドルフに本社を置き、2019年の売上高は1億2,600万ドルです。詳しくは、[当社ウェブサイト](https://www.congatec.com/jp/)、または[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449)、[Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG)、[YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)をご覧ください。

\* IntelおよびCoreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標または登録商標です。

**■本製品に関するお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　担当：奥村

TEL: 03-6435-9250 Email: sales-jp@congatec.com

**■本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　（同上） または

（広報代理）　プラップジャパン　高橋、谷本

Email: congatec@prap.co.jp